

웨이퍼의 배면 연마 보호

백그라인더 테이프 214D

특징

백그라인더 테이프는 웨이퍼의 배면 연마(백그라인더)시에 회로면을 외부 이물에 의한 상처, 칩핑(깨짐)이나 먼지 등의 오염으로부터 보호하기 위하여 사용 합니다.

- 회로면 등의 굴곡 웨이퍼에 대하여 우수한 밀착성
- 편리하고 쉬운 박리성

용도 반도체 웨이퍼의 연마 세정공정

구조

	점착층	0.08mm
	기재 (PET)	0.025mm
	점착층	0.03mm

특성

사양 기재 폴리에스테르 수지

물성

품명	두께 (mm)	점착력	
		강점착면 (N/25mm)	약점착면 (N/25mm)
214D	0.135	25	15

*PET#25 배면 타발 피착체:스텐레스

접합 후, 24시간 방치

인장각도 300mm/min 180도 Peel

사용 상 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.
- 상기 측정은 실온(23℃)하에서 테이프 입니다. 저온(5℃이하)의 경우, 점착력은 급격히 저하 될수 있습니다.

보관 상 주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관에 의한 특성저하를 일으킬수 있습니다.
- 보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하의(온도30℃이상 습도50%이상 금지)상태에 방치하지 말아 주십시오.

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: https://www.kgk-tape.co.jp/

2019년12월 発行